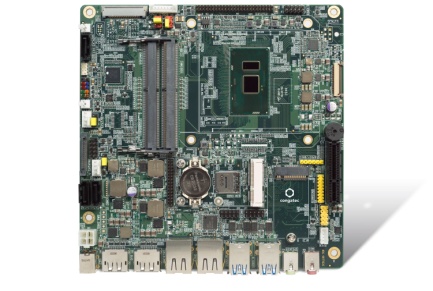
****

|  |  |
| --- | --- |
| **Вопросы читателей:** | **Контакты для прессы:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network** |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Phone: +49-991-2700-0 | Phone: +49-2405-4526720 |
| [info@congatec.com](mailto:info@congatec.com)  [www.congatec.com](http://www.congatec.com/) | [info@sams-network.com](mailto:info@prismapr.com)  [www.sams-network.com](http://www.sams-network.com) |



*Фото: Компьютерные модули сервер-класса: Новый COM Express Basic модуль компании congatec с процессорами Intel® Core™ 5-го поколения и Intel® Xeon®*

*Текст и фото доступны на сайте:* <http://www.congatec.com/press>

Пресс релиз от

**Компания congatec запускает тонкую системную плату индустриального класса форм-фактора тонкий мини-ITX на базе процессоров Intel® Core™ U седьмого поколения для подключаемых устройств Интернета вещей**

**Низкопрофильное решение для материнских плат с широкими возможностями!**

**Германия, Дегендорф, 07 марта 2017 года.** Компания congatec, лидирующая компания в области встраиваемых компьютерных модулей, одноплатных компьютеров, разработки и производства встраиваемых решений, а также предоставления производственных услуг, представляет свою новую продукцию conga-IC175 – семейство тонких материнских плат индустриального класса с новейшим процессором седьмого поколения Intel® Core™ U (кодовое наименование "Kaby Lake"), которые разработаны для подключенных устройств Интернета вещей. Новые платы идеально подходят для решений в технологии Интернета вещей с ограниченным пространством, требующих высокой производительностью при низком энергопотреблении. Кроме всего объема передовых характеристик процессоров нового поколения, новые платы также предлагают всестороннюю поддержку устройств Интернета вещей, включая сокет для SIM-карты с 3G/4G или узкополосное соединение (Narrow Band connectivity) и первую версию congatec IoT API, которые будут продемонстрированы на выставке Embedded World (зал 1, стенд 358).

Уникальное низкопрофильное исполнение нового семейства материнских плат индустриального класса от компании congatec в форм-факторе Thin Mini-ITX делает их идеально подходящими для систем в виде тонких конструкций, таких как: промышленные графические интерфейсы пользователя (GUI), человеко-машинные интерфейсы (HMI), системы цифровых рекламных/информационных панелей, терминалы для производства платежей в месте совершения покупки (POS-теримналов), а также медицинских таблетов. Новая плата выгодно выделяется из ряда похожих продуктов за счет использования в ней сверхбыстрой памяти Intel® Optane™, которая позволяет осуществлять очень быструю загрузку системы, укоренный запуск приложения, осуществления видеозаписи и обработку видео, а также обновления программного обеспечения. Плата также поддерживает технологию Hyper-Threading, которая при использовании гипервизора RTS в режиме реального времени превращает двухъядерную систему в систему 4-в-1.

"Наши новые материнские платы форм-фактора Thin Mini-ITX являются универсальными и могут применяться в самых различных встраиваемых решениях и приложений технологии Интернета вещей. Это связано с тем, что новые версии маломощных высокого класса 64-разрядных процессоров Intel® Core™ предлагают полностью настраиваемую конструктивную тепловую мощность TDP от 15 Вт, с гибкостью ее масштабирования от 7,5 Вт (TDP) до 25 Вт (TDP). Это позволяет достичь исключительного баланса мощности и производительности", - объясняет Мартин Данцер (Martin Danzer), директор по управлению продуктами congatec. Прекрасно приспособленные для встраиваемых приложений и устойчивые к жестким условиям эксплуатации эти изделия отвечают всем требованиям рынка товаров промышленного назначения. При этом, для флагманской материнской платы нового дизайна предусматривается ее доступность в долгосрочной перспективе не менее чем в 7 лет, а также полный набор индустриальных интерфейсов и драйверов. Благодаря поддержке персональной интеграции от компании congatec на этапе разработке конструкции проектирование конечного продукта значительно упрощается, что облегчает работу для инженеров-разработчиков OEM-продуктов.

**Набор функциональных особенностей в деталях**

Новые материнские платы индустриального класса conga-IC175 форм-фактора Thin Mini-ITX поставляются с четырьмя вариантами различных двухъядерных процессоров седьмого поколения Intel® Core™ U представляющими собой систему на кристалле (SoC) и имеют конфигурируемый TDP от 7,5 Вт до 25 Вт. Два разъема SO-DIMM поддерживают до 32 Гб памяти DDR4-2133. Для энергонезависимой памяти платы имеют один слот с поддержкой стандарта M.2, позволяя поддерживать память Intel® Optane™, отличающуюся значительно более низкой задержкой и высокой скоростью передачи данных по сравнению с остальными устройствами хранения информации. Два разъема интерфейса SATA 3.0 позволяют использовать дополнительные жесткие диски или твердотельные накопители. Новые платы с графикой Intel® Gen 9 HD 620, с последними возможностями DirectX 12, предлагают высокую производительность и поддерживают до трех независимых дисплеев с разрешением до 4k при частоте смены кадров 60 Гц, которая осуществляется путем использования двух портов DP++ и одного порта eDP, в сочетании с возможностью использования и двухканального LVDS.

Благодаря новому аппаратному ускорению 10-битное кодирование / декодирование видео в стандартах HEVC и VP9 разгружает CPU, в то время как поддержка HDR делает видео более яркими и живыми. Комплект поставки в индустриальном исполнении имеет набор входов/выходов, который включает в себя два порта Gigabit Ethernet и слот для SIM-карт с 3G/4G или узкополосного соединения M2M и возможностью подключения Интернета вещей. Кроме того к слоту PCIe x4 имеется один mPCIe для общих расширений, четыре порта USB 3.0, шесть портов USB 2.0, восемь GPIO и два последовательных COM-порта, один из которых может быть сконфигурированы как CCTalk. Наличие встроенного контроллера работы платы BMC (англ. BMC - Baseboard management controller, технологии удаленного управления сервером), HDA аудио, включая стерео усилитель с CSI-2 интерфейс MIPI для прямого подключения недорогих CMOS камер, а также дополнительным модулем TPM 2.0 завершает набор доступных функций в части подключения. Платы поддерживают 64-разрядные версии Microsoft Windows 10 и Windows 10 IoT, а также все распространенные версии операционной системы Linux. Для приобретения так же доступен широкий ассортимент аксессуаров, таких как: решения в части системы охлаждения, внешние панели ввода/вывода и различны кабели.

Новую плату conga-IC175 Thin Mini-ITX можно заказать со следующими процессорами

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Процессор** |  | **Число ядер / потоков** |  | **Intel®** **Кэш второго уровня (Smart Cache), Мб** |  | **Тактовая частота**  **стандарт/ турбо, ГГц** |  | **Мощность cTDP, Вт** |  | **Графика** |
| **Intel® Core™ i7-7600U** |  | **2/4** |  | **4** |  | **2.8/3.9** |  | **15/7.5/25** |  | **Intel® HD Graphics 620** |
| **Intel® Core™ i5-7300U** |  | **2/4** |  | **3** |  | **2.6/3.5** |  | **15/7.5/25** |  | **Intel® HD Graphics 620** |
| **Intel® Core™ i3-7100U** |  | **2/4** |  | **3** |  | **2.4** |  | **15/7.5** |  | **Intel® HD Graphics 620** |
| **Intel® Celeron® 3965U** |  | **2/2** |  | **2** |  | **2.2** |  | **15/10** |  | **Intel® HD Graphics 610** |

Для получения более полной информации по новым платам индустриального класса от компании congatec в форм-факторе Thin Mini-ITX посетите страницу представления продукта <http://www.congatec.com/products/mini-itx-single-board-computer/conga-ic175.html>

**About congatec AG**Headquartered in Deggendorf, Germany, congatec AG is a leading supplier of industrial computer modules using the standard form factors COM Express, Qseven and SMARC as well as single board computers and EDM services. congatec’s products can be used in a variety of industries and applications, such as industrial automation, medical, entertainment, transportation, telecommunication, test & measurement and point-of-sale. Core knowledge and technical know-how includes unique extended BIOS features as well as comprehensive driver and board support packages. Following the design-in phase, customers are given support via extensive product lifecycle management. The company’s products are manufactured by specialist service providers in accordance with modern quality standards. Currently congatec has entities in USA, Taiwan, China, Japan and Australia as well as United Kingdom, France, and the Czech Republic. More information is available on our website at [www.congatec.com](http://www.congatec.com) or via [Facebook](http://www.facebook.com/Congatec), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) and [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE).

\* \* \*

Intel и Intel Core, Xeon, IRIS являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Intel в США и других странах.